



2007年12月3日
芝浦メカトロニクス株式会社

高生産性枚葉式ウェットプロセッサ SC300GX を発売

～ 8 モジュール搭載、一括搬送機構の採用で、業界最高レベルの生産性を実現～

芝浦メカトロニクス株式会社 (社長 森田 茂樹、横浜市栄区笠間2-5-1)は、半導体デバイスの超微細化対応と省スペース化を実現した高生産性枚葉式ウェットプロセッサ「SC300GX」を完成し、2007年12月より受注を開始いたします。

本装置は、12月5日から開催されるセミコン・ジャパン 2007にてご紹介いたします。

1.概要

芝浦メカトロニクスでは、これまで枚葉式洗浄装置「SC300」シリーズを市場投入し、多くのお客様にご使用いただいています。また4モジュールタイプで230枚/時処理の「SC300」は、NANDフラッシュメモリー向けに多くの納入実績があります。

近年、半導体デバイス製造においては、製品コスト低減のため、回路線幅が65ナノメートルから45ナノメートルへと微細化が進んでいます。そして製造装置に対しては、「超微細化対応」に加え、「高生産性」と「省スペース化」の実現がますます強く求められています。このような動きに対応するため、芝浦メカトロニクスは本年6月、8モジュールタイプで430枚/時のスループットを達成した「SC300GX」をリリースしていますが、今回、SC300GXのフットプリントを約20%削減し、省スペース化を実現した「SC300GX」をリリースしました。

このSC300GX は次の特長を持っています。

芝浦メカトロニクス株式会社



2. 装置の特長

1) スループット:430枚 / 時。

最大 8モジュールの搭載と一括搬送機構の採用で、業界最高レベルのスループットを実現。

2) ロートポート数 :4ポート

3) 洗浄プロセス :

(a) 低ダメージ対応のスプレーノズル

マルチメガソニックノズル

(ウェーハ上に水膜を張りバーからメガソニックをかける機構。5MHzまで変調可能。)

(b) スプレー蒸気ユニット:

蒸気によるレジスト剥離やポリマー除去などが可能。

(c) 裏面洗浄 :ウェーハの最外周まで貫通可能なブラシスクラバーで対応。

(d) ベベル洗浄 :メガソニック、ブラシ、スプレーの中からツールを選択して対応。

4) 乾燥プロセス :

スピン乾燥で、横排気構造を採用。乾燥効率が高く、ウェーハ表面・端面の清浄度が高い。

5) 搬送システム 独自の高效率搬送システムを搭載。

6) 薬液供給ユニット:本体内蔵。

7) 適用プロセス :

ウェットエッチング、拡散前処理、機能水洗浄、裏面エッチング/洗浄、ベベルエッチング/洗浄等。

8) 対応薬液 :DHF / BHF、SPM、APM、O₃等

9) フットプリント:2150 W × 4050 D × 3000 H



3.今後の展開

芝浦メカトロニクスは、ドライプロセスとウェットプロセスの両方の要素技術を持っており、これらの技術を最適なバランスで組み合わせてソリューションとして提供することができます。

今後は「ユーザの視点に立った装置作り」という考えのもと、お客様の様々な要望にお応えし、お客様がより使いやすい、生産性の優れた装置を市場に提供していきます。

4.外観写真



以上

本件お問い合わせ先 : 芝浦メカトロニクス(株) 広報室 葛城 誠一

TEL 045-897-2425
FAX 045-897-2470